

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230821

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：半年度投资者交流电话会议
参与单位名称 及人员姓名	招商基金：张香滢、邹俊之、袁哲航；圆信永丰基金：胡春霞、党伟、刘诗涵；南方基金：陈卓；广发基金：顾益辉；兴证全球基金：任相栋、陈勇、李楠竹；华夏基金：张皓智；富国基金：王佳晨；中银基金：张响东；景顺长城基金：李南西；国联安基金：王栋、魏东；太平洋资产：陈永亮；睿郡资产：刘力、薛大威；理成资产：吴圣涛；高毅资产：赵浩、张新和等 340 名投资者及证券人员
时间	2023 年 8 月 20 日 20:30-21:30 2023 年 8 月 21 日 11:00-12:00
地点	电话会议
上市公司接待 人员姓名	总经理朱顺全先生、董事会秘书杨平彩女士、财务总监姚红女士
投资者 关系活动 主要内容 介绍	<p>管理层介绍公司基本情况，并与投资者就公司半导体材料业务、打印复印通用耗材业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下：</p> <p>问 1：公司三个新业务的数据季度环比还是比较明显的往回走的，如何展望三四季度？</p> <p>答：上半年度，公司半导体材料产品实现销售收入 2.25 亿元，其中第二季度销售收入为 1.37 亿元，较第一季度销售收入 8,897 万元环比增长 54%，季度环比增幅明显。目前来看，抛光垫 7 月份环比 6 月份增幅有 20%，我们预估三季度会继续保持增长态势；抛光液和清洗液目前有多款产品都在客户端进行测试，部分重点型号产品有望在今年下半年导入客户并贡献收入，虽然鼎泽今年很难盈利，但其单月的亏损是不断下降的；显示材料 YPI、PSPI 产品现均已成为国内部分主流面板客户的第一供应商，下半年会继续稳定增长，柔显首次实现扭亏为盈，也印证了公司新材料平台的盈利模式的能力。</p> <p>问 2：公司半导体材料毛利率下降的原因？</p> <p>答：公司显示材料、抛光液及清洗液销量同比增长显著，影响半导体材料的产品结构变化，从而影响整体毛利率下降。此外，公司抛光垫受销量下降影响，毛利率略有下降。</p> <p>问 3：抛光垫之前的净利率是很高的，上半年盈利有点下滑，这个是因为什么？</p>

	<p>答：公司抛光垫产品净利率下降主要是受销量下降导致折旧提高，再加上潜江三期抛光垫新品侵蚀了一部分利润，但是公司抛光垫价格是比较稳定的，不考虑折旧因素，单位利润是没有变化的。</p> <p>问 4：研磨粒子有何重要性？对成本重要还是对性能也很重要？</p> <p>答：研磨粒子在抛光液原料成本中占比最高，实现自主制备能降低抛光液的成本，提升抛光液产品的潜在毛利空间；但是对于品质更重要，研磨粒子的尺度是纳米级，极微小的波动都会对产品质量产生重大影响，公司可以从研磨粒子的性质入手，对抛光液产品定制化开发，使产品性能契合客户的使用需求。</p> <p>问 5：公司研发布局情况？</p> <p>答：作为进口替代类创新材料的平台型公司，公司布局了集成电路制造 CMP 抛光环节的多款核心耗材，提供 CMP 制程工艺材料系统解决方案；在显示材料领域，公司正在推进面板封装材料 INK、面板平坦保护材料 OC 等多款核心半导体显示材料的开发验证、市场推广工作；在先进封装材料领域，公司重点布局了技术难度高、未来增量空间比较大的临时键合胶（TBA）、封装光刻胶（PSPI）等几款材料产品；子公司旗捷科技在向工业级和车规级应用的安全芯片等新产品方向进行深度转型；此外，公司也将持续在一些关键大赛道进口替代类创新材料领域进行探索布局。</p> <p>问 6：仙桃工厂的产能建设进展？</p> <p>答：公司仙桃光电半导体材料产业园是去年 6 月 28 号开始开工的，一期项目包括有年产 1 万吨清洗液扩产项目、年产 2 万吨 CMP 抛光液扩产项目、年产 1 千吨 OLED 用 PSPI 产业化项目、年产 600 吨 OLED 封装材料 INK 产业化项目，以及第三代半导体用研磨粒子、集成电路 CMP 高纯研磨粒子、光电半导体柔性显示用其他关键材料产业化项目。仙桃产业园建设工程已进入全面收尾阶段，其中 PSPI、抛光液及清洗液产业化项目现已完成工艺安装，预计于今年第四季度全面竣工，开始试生产供应，为后期持续稳定放量奠定基础。</p> <p>问 7：公司半导体先进封装材料业务的进展情况如何？</p> <p>答：公司布局的几款先进封装材料均为国内尚未实现自主化替代、技术门槛高、国内的市场空间在十亿元以上的产品。目前公司先进封装材料相关产品开发、验证按计划快速推进，进展均符合公司预期。其中，临时键合胶产品在国内某主流集成电路制造客户端的验证及量产导入工作基本完成，预计于今年年内获得首笔订单；封装光刻胶产品已完成客户端送样，验证工作稳步推进，截至目前客户验证反馈良好。</p> <p>问 8：公司上半年耗材收入是下降的，如何展望下半年？</p> <p>答：一三季度是耗材行业的淡季，正常来说下半年会比上半年好一点。随着下半年旺季的到来，公司耗材业务在下半年将会有更好表现。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 8 月 21 日